

## 第 32 回宇宙用部品連絡会アジェンダ

日時： 平成 26 年 2 月 7 日（金） 13 : 30～16 : 30

場所： 御茶ノ水ソラシティ 1F

ソラシティカンファレンスセンター Room B

1. 開会の挨拶
2. JAXA からの情報
  - 2.1 部品開発状況 (13 : 30～14 : 00 30 分)
  - 2.2 POL の追加データの取得について
  - 2.3 JAXA 認定部品の EPPL 登録の促進について
3. 部品ユーザからの情報 (14 : 00～14 : 20 20 分)
  - 3.1 三菱プレジジョン(株)
4. 部品メーカーからの情報 (14 : 20～15 : 00 40 分)
  - 4.1 EEPROM の新規認定（結果報告）／HIREC(株)
  - 4.2 エリア アレイ パッケージ 設計対応プリント配線板の新規認定（結果報告）／山梨アビオニクス(株)
  - 4.3 表面実装形 ミニチュア限流ヒューズ の新規認定（結果報告）／(株)立山科学デバイステクノロジー
  - 4.4 ふっ素樹脂/ポリイミド樹脂絶縁電線の材料変更（状況報告）／日立金属(株)
  - 4.5 端子強度試験方法、QCI グループ A1 群試験順変更に関する報告／(株)福井村田製作所
- ◆休 憩◆ (15 : 00～15 : 15 15 分)
5. 部品生産のスケジュールに関するお知らせ (15 : 15～15 : 20 5 分)
  - 5.1 POL／日本アビオニクス(株)
6. QPL／QML 部品認定状況報告 (15 : 20～15 : 30 10 分)
  - 6.1 共通部品等の認定状況
  - 6.2 QTS／ADS の改定状況
  - 6.3 認定部品の変更管理状況
7. 海外情報 (15 : 30～16 : 20 50 分)
  - 7.1 海外宇宙機関 関連情報
  - 7.2 G12/11 報告
  - 7.3 ISTFA 報告
8. その他 (16 : 20～16 : 30 10 分)
  - 8.1 第三回半導体デバイスの放射線照射効果研究会のお知らせ／HIREC(株)
  - 8.2 イベント報告及び次年度の予定
9. 閉会の挨拶

※意見交換会（17 : 00～19 : 00）